**國家中山科學研究院飛彈火箭研究所**

**108年第四次人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

全時工作人員研發類28員、技術生產類14員、行政管理類2員，共計44員，依「國家中山科學研究院飛彈火箭研究所108年第四次人力進用招考員額需求表」辦理(如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：依本院新進人員薪資核敘基準表之薪資範圍內，核給基本薪。

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)得依條件申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)轉任人員，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休資遣撫卹法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(**持國外學歷者，需符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格**)

(一)研發類：

1.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具學校開立證明書認定，或由用人單位自行審查認定。

2.報考人員學歷高於所報考之工作編號學歷需求，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(二)技術生產類、行政管理類：

1.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件。

2.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

三、其他限制：有下列情形之一者，不得進用；若於進用後本院始查知錄取人員有下列限制條件者，因自始即未符合報考資格，本院得取消錄取資格，並不得提出異議︰

(一)履歷內容填寫不實或於應徵過程中為虛偽意思表示及舞弊者。

(二)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(三)無行為能力或限制行為能力者。

(四)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(五)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(七)因案被通緝或在羈押、管收中。

(八)依法停止任用者。

(九)褫奪公權尚未復權者。

(十)受監護宣告尚未撤銷者。

(十一)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十二)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十三)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之處分者。

**肆、報名時間及方式：**

1. 甄試簡章公告時間至**108年9月30日止**，其甄試時間得依實際狀況彈性調整之。
2. 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw) 填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件2)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷(投遞說明如附件4)。
3. 本所擇優篩選並完成資格審查後，以電子郵件或簡訊通知參加甄試。未獲選取者不另行通知。
4. 不接受紙本報名及現場報名。
5. 為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件3)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。
6. 應屆畢業生報名甄試時尚未取得畢業證書者，僅需繳交學生證掃描檔查驗。前述人員錄取後，需於本院寄發錄取通知日起至報到日期間，繳驗畢業證書正本(如為學校因素無法如期繳交，須出具學校開立之佐證證明)，若無法繳驗，則取消錄取資格。
7. 歡迎具身心障礙身分或原住民身分且符合報考資格者報名參加甄試，請於人才資料庫登錄資料時及履歷表上註記。

**伍、報名應檢附資料：報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。各項資料務必依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳至本院網路徵才系統，並請自行調整資料版面之呈現方向，以利閱讀，ＰＤＦ檔名請設定：「考生姓名\_履歷」**

1. 履歷表：**請依照附件2格式填寫，**並依誠信原則，確實填寫於本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，經查屬實者，本院得予不經預告終止契約解除聘雇。
2. 符合報考學歷之畢業證書掃描檔。
3. 報考所需之個人相關掃描檔資料(如：符合報考學歷畢業證書、工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等)，請參考簡章之員額需求表。
4. 提供工作經歷證明者，格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。
5. 若有繳交民營機構之工作經歷證明，需再檢附**歷年勞保異動明細表**(如：勞保、公保、農保…等)，如未檢附，該工作經歷不予認可。(「勞保投保明細表」可利用「自然人憑證」至勞保局網站「勞工保險異動查詢」下載，需內含(曾)任職公司投保薪資、投保生效與退保日期)。
6. 具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。
7. 具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。
8. 各項上傳資料之正本於錄取後報到時統一辦理繳驗，凡有偽造證件不實者，一律註銷錄取資格。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

1. 甄試日期：暫定於108年10月舉辦(實際甄試時間以甄試通知為準)。
2. 甄試地點：暫定於本院新新院區(桃園市龍潭區)(實際甄試地點以甄試通知為準)。
3. 甄試方式：甄試科目及配分請參閱員額需求表

(一)研發類：

1.初試：書面審查/口試初試。

2.口試複試。

(二)技術生產、行政管理類：

1.實作/筆試。

2.口試。

1. 甄試當日如遇天災、事變及突發事件(如：颱風來襲)等不可抗力之原因，本所得視情況合理之調整甄試作業時間、地點及甄試方式並應即通知應考人員。
2. 各項甄試作業(如：時間、地點…等)均以電子郵件或簡訊通知應考人員。請考生務必留意報考時提供之電子郵件帳號及手機號碼。若以電子郵件或簡訊通知無法聯繫到考生，視為該考生放棄報考，不再另行通知。
3. 口試甄試時，若考生未於規定時間內完成報到手續，需主動以電話先行告知，報到時間得視情況順延(1小時內為原則)。

**柒、錄取標準：**

1. 甄試合格標準：
2. 初試單項(書面審查/筆試/實作/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。
3. 複試口試合格標準為70分(滿分100分)
4. 初、複試總成績合格標準為70分(滿分100分)。
5. 如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。
6. 成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取。

1.研發類：總成績為口試複試平均成績。

2.技術生產類、行政管理類：總成績為各單項成績依比例計算後加總。

(二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平 均較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

2.技術生產類、行政管理類：依序以實作平均成績/筆試單一成績(若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)、口試平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

1. 儲備期限：

(一)完成各階段甄試後合格但未錄取之應徵者得設為備取人員， 並由單位依成績排定備取順序，依序備取，儲備期限自甄試結果奉本院督導副院長核定次日起4個月內有效。

(二)人員錄取或遞補來院報到後，其他於本院應徵職缺之錄取或遞補皆視同自動放棄。

**捌、錄取通知：**

1. 甄試結果預由本院於甄試後1個月內以電子郵件通知，各職缺錄取情形不予公告。
2. 人員進用：錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

電子信箱：mrsrd6503@ncsist.org.tw

總機：(03)471-2201或 (02)2673-9638

聯絡人及分機：邱來聲 副組長352268

丁樂珍 小 姐352232

沈陞豪 先 生352478

林育菁 小 姐352028

**請再次確認報名檢附資料是否齊全**

●**報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。**

●**各項資料務必依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳至本院網路徵才系統。並請自行調整資料版面之呈現方向，以利閱讀，ＰＤＦ檔名格式：「考生姓名\_履歷」**

**□履歷表**

請依照附件2格式填寫，並依誠信原則，確實填寫於本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，經查屬實者，本院得予不經預告終止契約解除聘雇。

**□畢業證書**

應屆畢業生報名甄試時尚未取得畢業證書者，需繳交學生證掃描檔查驗。

**□報考所需之個人相關資料**

如：符合報考學歷畢業證書、工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等，請參考簡章之員額需求表。

**□工作經歷證明**

格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。

**□歷年勞保異動明細表**

需內含(曾)任職公司投保薪資、投保生效與退保日期，如未檢附，該工作經歷不予認可，無工作經驗者免提供。

**□具身心障礙身分者**，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。

**□具原住民族身分者**，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。

**□本院同仁**

需上傳經單位主管核章之招考報名申請表掃描檔(如附件3)。

**\*各項上傳資料之正本於錄取後報到時統一辦理繳驗，凡有偽造證件不實者，一律註銷錄取資格。**

附件1

| **國家中山科學研究院飛彈火箭研究所108年第四次人力進用招考員額需求表** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作编號** | **職類** | **學歷需求** | **薪資**  **範圍** | **專長**  **(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求**  **員額** | **工作地點** | **甄試**  **方式** |
| 1 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/航空等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具推進相關研發工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.各型固體火箭發動機之研發，包括設計、測試、分析等。  2.系統工程，包括系統規劃、分析，介面協調、整合等。 | 2 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 2 | 研發類 | 碩士 | 56,650  |  65,000 | 機械/造船 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符):**  1.機械/造船/航空/應用力學/機電/系統科學/工程科學/動力機械/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具船舶設計等相關工作經驗1年(含)以上。  2.熟悉下列軟體: SolidWorks與AutoCAD。 | 船舶與水下載體壓力殼設計、艙間佈置、舵翼設計、壓載水櫃設計與物性控制。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 3 | 研發類 | 碩士 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符):**  1.機械/航空/應用力學/造船/工程科學/動力機械/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **\* 具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具熱流相關研發工作經驗。  2.具流體力學/熱流學等相關領域之研究經驗。  3.具有熱流試驗或分析軟體使用工作經驗。  4.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.熱控制系統設計、分析、高溫熱防護設計、熱傳試驗等。  2.熱流數值計算網格建立及相關數值模擬分析。 | 2 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 4 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **\*具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具類比、數位電路、單晶片設計經驗。  2.具下列開發經驗之一：C++/Linux /Matlab /LabVIEW/內嵌式程式。  3.具通訊與數位信號處理經驗。  4.具FPGA/ASIC設計經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.慣性及衛星接收機導航系統軟硬體開發。  2.DSP/ARM處理器軟體/韌體/硬體開發研製。  3.運用FPGA VHDL，VERILOG等相關語法工具，進行數位電路縮裝開發設計。 | 3 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 5 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 控 制 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.航太/機械/電機/電控/應用力學/工程科學/土木/船舶/數學/物理等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.控制系統分析/設計或模擬修習或工作經驗。  2.應用力學及流體力學修習或工作經驗。  3.導引律設計/分析或模擬修習或工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.飛行控制系統(自動駕駛儀)設計。  2.6-DOF Simulation (六自由度模擬)。  3.導引律設計。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 6 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/應用力學/航太/造船/動力/系統工程/機電/土木等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具Pro/E或Solidworks等3D CAD軟體或具機械設計能力。  2.具有限元素分析軟體使用經驗。  3.具機構分析軟體使用經驗。  4.具液/氣壓系統設計工作經驗。  5.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或上課證明。 | 執行機械零組件、機構系統及液/氣壓系統之研發設計、分析模擬、製造、組裝、測試驗證等。 | 2 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 7 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 電子/電機/資工 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/機械/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.熟悉AUTOCAD或PRO E繪圖軟體，電路分析及電路設計。 | 系統電路設計及繪製、電控零件選用及系統安裝及維護。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 8 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機/資工 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/機械/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.熟悉C/C++程式語言。  2.具Visual Studio、MFC、Qt、CAN bus、LabWindows/CVI等開發經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.整合電子、馬達或液壓控制、通信之人機介面或操控軟體開發，主要作業平台包含Windows及Linux。  2.內嵌式系統之韌體開發，主要的CPU包含 8086、8051、ARM等。  3.PXI測試系統之控制程式開發撰寫。 | 1 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 9 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 資訊/電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.資訊/電子/電機/控制/電信/光電工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統軟體開發工作經驗。  2.具C/C++/Java電腦程式語言撰寫能力及工作經驗。  3.具linux系統及Qt IDE跨平台程式開發工作經驗。  4.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或上課證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.導航、導控、飛控或射控應用法則於嵌入式系統軟體研發。  2.應用微軟視窗或linux等作業系統上之人機介面程式開發。  3.系統核心設計與測試，開源即時作業系統導入及應用軟體研發。  4.系統分析模擬，測試系統整合設計。  (需配合加班及出差) | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 10 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 資訊/電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.資訊/電子/電機/控制/電信/光電工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統硬體開發工作經驗。  2.具C/C++/Java電腦語言能力，撰寫中層驅動界面程式工作經驗。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或上課證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.微處理器(微控制器)為基礎之數位電路設計、測試與驗證。  2.處理器內核之晶片系統(SOC) 之數位電路設計、測試與驗證。  3.通訊介面硬體之設計、測試與驗證，或及驅動韌體。  4.閘陣列數位介面(FPGA) 之設計、測試與驗證。  5.類比介面之設計、測試與驗證。  (需配合加班及出差) | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 11 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/電信/控制/光電/資訊工程/通訊/動力機械/電控等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  4.具C語言或LabVIEW開發經驗(表列已完成開發之系統名稱或功能概述)或認證證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具電子/電機/電信/控制/光電/資訊工程相關工作經驗。  2.具嵌入式系統設計/實現/應用相關工作經驗。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.測試器軟硬體開發設計/嵌入式系統應用開發。  2.PXI模組化測試系統研發設計。  3.類比及數位控制電路設計/分析與驗測。  4.測試器故障診斷及排除。 | 3 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 12 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/控制等理工系所或其他理工系所之電子/電機/控制相關組別畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具C語言或LabVIEW開發工作經驗。  2.具電路設計或DSP韌體撰寫等相關工作經驗。  3.具能源管理控制器軟韌體開發/電動車電池系統韌體及硬體開發/再生能源儲能系統整合應用/電池測試/電動車控制器開發應用等相關工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.能源管理控制器軟韌體開發。  2.電動車電池系統韌體及硬體開發。  3.再生能源儲能系統整合應用。  4.電池測試。  5.電動車控制器開發應用。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 13 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 專案管理/生產管理 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.工業工程/機械等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具專案管理/生產管理工作經驗1年(含)以上。  2.具各項專案管理技能檢定成績或證照。  3.具機械類加工製造檢驗與品質管理工作經驗。  4.具機械藍圖識圖能力或經驗。  5.具資料庫大數據處理經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.負責專案管理生產管理工作。  2.專案硬品產製規劃及管制與生產數據分析。  3.工廠管理相關資訊需求規劃與設計。  4.產製現代化工作規畫及推動。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 14 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具有機械設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。  2.曾從事機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。  3.具液壓設備或組件測試設備開發及測試程式設計規劃撰寫等相關工作經驗1年(含)以上。  4.具備CAD/CAM製程設計工作經驗。  5.熟悉機械設計Solid Works繪圖軟體。  6.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.機械設計/製造及產品製程規劃/研發/產能籌建/測試分析等產製。  2.精密液壓組件、超低溫致冷器研發，含籌料、零件製造/組件組裝/總成測試等技術開發。 | 4 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 15 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具Keil C語言開發能力或工作經驗。  2.具微處理器/DSP、FPGA等嵌入式系統開發工作能力或工作經驗。  3.具類比/數位電路/單晶片設計整合經驗。  4.具電子電路整合設計能力或工作經驗。  5.具電力電子系統整合設計能力或工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.航太模組控制軟體/韌體開發。  2.軟體/韌體、DSP數位電路及微處理器軟硬體開發研製。  3.系統核心設計與測試/系統分析模擬。  4.電力電子系統設計與開發。  5.類比及數位控制電路設計/分析與驗測。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 16 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 機械/航空/造船 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力/飛機/冷凍空調等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具專案管理/系統工程/生產管理相關工作經驗。  2.具MS Office軟體(含Project)操作能力。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公/民營機構訓練證照/證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.專案計畫系統工程及計畫管理之推動與管制。  2.飛彈、火箭及相關武器系統裝備之研發、生產和後勤之系統整合，以及硬品產製與預算支用之規劃和管制。  3.經濟部、科技部或國防部之科技專案的建案及執行。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 17 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/應用力學/動力/土木/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC650/托福成績IBT65/ CBT170/PBT500證明資料。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具機械設備設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。  2.具結構與機構之動靜態設計/分析/測試背景及CAD/CAE 軟體工作經驗。  3.具高壓氣體管線設計/分析/繪圖工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.設備結構、機構、關鍵組件及相關裝備設計、開發、分析或試驗等。  2.高壓氣體管線之管路規劃、設計繪圖、分析與操作等。 | 2 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 18 | 技術生產類 | 大學 | 38,110  |  45,000 | 車 床 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  學歷需符合下列條件之一：  1.機械科系畢業。  2其他理工科系畢業者，需具CNC車床/機械加工乙級(含)以上技術士證照。  3.非理工科系畢業者，需具CNC車床/機械加工乙級(含)以上技術士證照及機械相關工作經驗1年(含)以上。  4.未符合上述條件者，需具機械相關工作經驗3年(含)以上。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具製程規劃/藍圖視圖能力或CAD/CAM軟體使用能力。  2.具CNC車床/機械加工類乙級(含)以上技術士證照。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公/民營機構訓練證照/證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.武器系統各機械零組件車床加工等相關工作。  2.複合材料工件車床加工。  3.CNC車床加工程式撰寫等相關工作。 | 2 | 桃園  龍潭 | **1.實作60%：**  NC車床  **實作範圍：**  手寫NC程式並輸入機台控制器(FANUC)執行加工  (70分合格)  **2.口試40%**  (70分合格) |
| 19 | 技術生產類 | 大學 | 38,110  |  45,000 | 鈑 金 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  學歷需符合下列條件之一：  1.機械科系畢業。  2.其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具鈑金/冷作相關丙級(含)以上技術士證照。  2.具鈑金/冷作工作經驗2年(含)以上。  3.高中職鈑金/冷作科畢業。 | 1.鈑金折彎/旋壓及捲製成型工作。  2.各種材料捲管/修配與整型工作。  3.電控系統箱櫃/車廂製作/修改與組裝工作。 | 5 | 桃園  龍潭 | **1.實作60%：**  鈑金/冷作  **實作範圍：**  鈑金展開技術  (70分合格)  **2.口試40%**  (70分合格) |
| 20 | 技術生產類 | 大學 | 38,110  |  45,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  學歷需符合下列條件之一：  1.電子/電機/電力控制等理工科系畢業。  2.其他理工科系畢業者，需具電子/電機相關乙級(含)以上技術士證照。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具基本電路設計經驗。  2.具公/民營機構訓練證照或證明。  3.具電機電子類技術士丙級(含)以上證照。  4.具電路板錫焊工作經驗1年(含)以上。 | 1.電路製作、電子零件錫焊，電路板、設備及訊號線檢修及線束接頭製作。  2.電子電機裝備系統測試、模組單元組裝及操作，儀器操作及保養，線束測試與通聯試驗，佈線施工、故障診斷及排除。  3.需外地及出海量測相關工作。 | 3 | 桃園  龍潭 | **1.筆試60%：**  電子學  **參考書籍:**  電子學I(華興文化事業有限公司陳昇編著)  (70分合格)  **2.口試40%**  (70分合格) |
| 21 | 技術生產類 | 高中 | 30,900|  37,000 | 線 切 割 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  學歷需符合下列條件之一：  1.機械群科系畢業。  2其他理工科系畢業者，需具CNC銑床/機械加工類乙級(含)以上技術士證照。  3.非理工科系畢業者，需具CNC銑床/機械加工類乙級(含)以上技術士證照及機械相關工作經驗1年(含)以上。  4.未符合上述條件者，需有機械加工類相關工作經驗3年(含)以上。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具操作線切割加工經驗/曾於公立職訓中心受訓。  2.具製程規劃與藍圖視圖能力。  3.具CNC/機械加工類乙級(含)以上技術士證照。 | 至少從事下列工作之一：  1.機械或精密零件線切割加工製造。  2.CNC線切割加工程式撰寫。  3.計畫專案線切割生產作業。  4.線切割模夾具加工。 | 1 | 桃園  龍潭 | **1.實作60%：**  線切割實作  **實作範圍：**  操作AGIE CNC線切割機台執行夾持及定位製件並進行加工  (70分合格)  **2.口試40%**  (70分合格) |
| 22 | 技術生產類 | 大學 | 38,110  |  45,000 | 非破壞  檢測 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.學歷需符合下列條件之一：  (1)機械/航空/輪機/造船等科系畢業，須具射線檢測初級檢測師證照及射線檢測照相工作經驗3年(含)以上。  (2)非上述科系畢業者，須具射線檢測中級檢測師證照及射線檢測判片工作經驗5年(含)以上。  2.需檢附大學各學年成績單。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.射線檢測中級/初級檢測師證照。  2.具輻射防護員資格/輻射安全證書執照(或測驗成績及格通知書)。 | 1.銲接件/金屬鑄件及複合材料等硬品道次射線檢測。  2.品質文件資料建立及工件接件/轉出作業。 | 1 | 桃園  龍潭 | **1.筆試60%**：  非破壞檢測  **參考書籍：**  射線檢測法(初、中級)  (財團法人非破壞檢測協會出版)  (70分合格)  **2.口試40%**  (70分合格 |
| 23 | 技術生產類 | 大學 | 38,110  |  45,000 | 資訊 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  學歷需符合下列條件：  1.資訊/電腦/電子/電機/工業工程/工業管理等科系畢業。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具MS SQL資料庫管理  經驗。  2.具網頁維護經驗。  3.具電腦維修經驗。  4.具相關資訊證照者。 | 1.網頁維護。  2.機房管理。  3.資料庫維護。  4.電腦檢修。  5.資訊安全相關維護工作。  6.臨時交付任務。 | 1 | 桃園  龍潭 | **1.筆試60%：**  MS SQL語法  **參考書籍：**  請參考微軟SQL SERVER 線上叢書  (70分合格)  **2.口試 40%**  (70分合格) |
| 24 | 技術生產類 | 大學 | 38,110|  45,000 | 化學/化工 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  學歷需符合下列條件：  1.化學/化工等科系畢業。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具有機分析或重金屬  檢驗分析或化學儀器  操作等實驗室工作經  驗。  2.具化學乙級(含)以上  技術士證照。 | 從事下列工作：  1.表面處理、電鍍、化成槽液分析。  2.協助產線藥液化學分析方法的開發與改善。 | 1 | 桃園  龍潭 | **1.實作60%:**  化學分析實作  **實作範圍:**  1.藥液濃度分析  2.分析化學  (參考書目:分析化學(2版)，作者:魏明通)  (70分合格)  **2.口試40%**  (70分合格) |
| 25 | 行政管理類 | 大學 | 33,990|  40,000 | 申購管理 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械系為佳；其他科系畢業亦可。  2.需檢附大學(含)以上各學年成績單。  3.具行政院公共工程委員會採購專業人員證書。  4.具採購/供應商管理相關工作2年(含)以上經驗。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具藍圖識圖能力/經驗。  2.具機械類刀工具庫管作業能力/經驗。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.辦理採購案徵商訪價/建案申購/訂約及履約驗結等作業。  2.負責申購管理/購案稽核及程序審查等相關事務作業。  3.刀工量具等管理及採購業務。 | 2 | 桃園  龍潭 | **1.筆試60%：**  採購法  **參考書籍：**  政府採購法，(出版社:公共工程委員會)  (70分合格)  **2.口試40%**  (70分合格) |
| 合計：研發類28員，技術生產類14員，行政管理類2員，共計44員。 | | | | | | | | | |

附件2

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名  (與護照相同) | |  | | ★身分證  號碼 | | | | |  | | | | 最近三個月  1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | | 年月日 | | 婚姻 | | | | | □已婚 □未婚 | | | |
| ★兵役狀況 | | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) | | | | | | | | | | | | |
| ★電子郵件 | |  | | | | | | | | | | | | |
| ★通訊處 | 戶籍  地址 |  | | | | | | | | | | 行動電話 | | |  |
| 通訊  地址 |  | | | | | | | | | | 連絡電話 | | |  |
| 居住國外在台聯絡人員  (緊急聯絡人) | |  | | 行動電話 | |  | | | | | 連絡電話 | | |  |
| ★  學歷 | 學校名稱 | | | | 院系科別 | | | | 學位 | | | 起迄時間 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★  經歷 | 服務機關名稱 | | | | 職稱(工作內容) | | | | | | | | 起迄時間 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 家庭狀況  ★ | 稱謂 | 姓名 | | | 職業 | | | | | 服務機關 | | | 連絡(行動)電話 | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三親等親屬及朋友  在中科院任職之  ★ | 關係(稱謂) | | 姓名 | | | | | 單位 | | | | | | 職稱 | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | | | | 體重：　　 　　　公斤 | | | | | | | | 血型： 　　　型 | | |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | | | | | | | | 族 別：　　　 　　　　　族 | | | | | |
| 身心  障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | | | | | | | | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) | | | | | |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 自述(本表若不敷使用請自行延伸) |
|  |

　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依報考工作編號學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修，如未檢附者，視同資格不符**

1. 畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

1. 學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

1. 學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

1. 英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

1. 具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

1. 相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

1. 其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

**履歷表補充附表**

**填表日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ★**姓名** | | |  | | | | | | | |
| **2** | ★**報考職類** | | | □研發類　 □技術類　 □行政、管理類 | | | | | | | |
| **3** | ★**報考項次** | | |  | | | | | | | |
| **4** | **前一份工作月薪** | | | 元 | | | **前一份工作年薪** | | 元 | | |
| **5** | ★**預期月薪** | | | 元 | | | ★**可接受最低月** | | 元 | | |
| **6** | **語言能力** | | |  | | | | | | | |
| **7** | **專長** | | |  | | | | | | | |
| **8** | **本院產學合作案或其他合作計畫** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 計畫名稱 |  | | | 期程 | 至 | | 本院合作單位 | | |  |
| **9** | **證照** | | | | | | | | | | **計\_\_\_\_張** |
| **10** | **論著** | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **碩士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.2** | **博士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.3** | **國內外學術期刊發表論文** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.3.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 發表期刊名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.4** | **國內外研討會發表論文** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.4.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 研討會名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.5** | **其他著作** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.5.1 | 著作名稱 | |  | | | | | | | | |

(本表若不敷使用請自行延伸) 備註：有★為必填欄位

附件3

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現職單位  （至二級） | | 姓名  (身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷  (含科/系/所) | |
|  | |  |  |  | |
| 擬參加甄選單位職缺 | | | | | |
| 報考單位(或工作編號) | | | 職類 | | 職缺 |
|  | | |  | |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | | 一級單位主管批示 | | |
| 電話： |  | |  | | |
| 一級人事單位 | |
|  | |

備註：非本院現職員工免填。

附件4

中山科學研究院徵才系統履歷投遞說明

1.請先至中科院官網：(<http://www.ncsist.org.tw/csistdup/main/Default.aspx>)點擊「菁英招募」查看最新招募簡章。

2.欲投遞履歷時請直接點選:點我投遞履歷。

3.欲知詳細說明請點閱:投遞說明。

